

合肥颀中科技股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2025-008

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演/反路演活动<br><input checked="" type="checkbox"/> 现场参加 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议<br><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 来访单位名称        | 长江证券、兴业证券、英大信托、东方阿尔法、财通资管、银叶投资、摩根基金、重阳投资、天弘基金、鹏华基金、建信基金、华富基金、上银基金、华宝基金、中金资管等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 时间            | 2025 年 10 月 15 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 上市公司接待人员姓名    | 总经理：杨宗铭<br>副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>1. 问：黄金价格的波动会对公司有什么影响？</b><br/>答：黄金主要用于显示驱动芯片上，而公司目前生产上所用到的黄金成本基本可转嫁至下游客户，由其承担价格波动的主要风险，因此黄金价格波动对公司产品成本影响不大。</p> <p><b>2. 问：公司 2025 年和 2026 年的股份支付费用是多少？</b><br/>答：根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》中测算，公司 2025 年和 2026 年的股份支付费用约为 6,800 万元和 5,200 万元。</p> <p><b>3. 问：公司发展非显示的布局？</b><br/>答：公司的非显示主要以电源管理芯片、射频前端芯片（功率放大器、射频开关、低噪放等）为主，少部分为 MCU（微控制单元）、MEMS（微机电系统）等其他类型芯片，可广泛用于消费类电子、通讯、家电、工业控制等下游应用领域。公司以稳中求进的策略，基于现有 bumping 客户，延伸我们的服务范围到 package-level 的封装测试服务，可降低现有客户需要再委外封测的成本；后续再藉由先进功率及倒装芯片封测技术改造项目将新导入 BGBM/FSM、Cu Clip、覆晶封装 FCQFN/FCLGA 制程，进一步完善非显示类芯片封测全制程产能，并在现有电源管理芯片、射频前端芯片的基础上，新增功率器件封装布局，提升公司在非显示类芯片封测领域的市场竞争力。</p> |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p><b>4. 问：BGBM、FSM、Cu Clip 制程的工艺介绍？</b></p> <p>答：BGBM 工艺指将功率芯片减薄至指定厚度，并在晶背上覆盖金属层，典型组合如 Ti/NiV/Ag；FSM 工艺指在功率芯片正面导通铝垫上形成金属层，典型组合如 Ti/NiV/Ag。此工艺可使得功率芯片获得超低的导通电阻值、更高的电流承载量、更快的开关速度以及更好的导热性能。Cu Clip 是一种功率芯片封装技术，通过高精度铜片替代传统引线键合（Wire Bonding），实现更低的电阻、更好的散热性能和更高的电流承载能力。</p> <p><b>5.问：公司显示和非显示收入的占比？</b></p> <p>答：2025 年上半年度，公司显示收入占比约 93%，非显示收入占比约 7%。</p> <p><b>6.问：公司会考虑涨价吗？</b></p> <p>答：目前综合考量下，公司预计仍以保持价格的稳定为优先。后续，公司将视市场供需情况，再做进一步评估。</p> <p><b>7.问：公司高端测试机的扩产计划？</b></p> <p>答：目前公司的高阶测试机仍在持续进机中；进机台的速度和数量则会根据目前订单的掌握情况并兼顾设备供应商的交期和出货数量限制等因素，综合考虑后弹性调整。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明 | 本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 附件清单（如有）              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 日期                    | 2025 年 10 月 16 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |